证券代码：002745　　证券简称：木林森　　公告编号：2026-033

木林森股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

木林森股份有限公司（以下简称“公司”或“木林森”）第六届董事会第十次会议于2026年11月20日以现场加通讯的表决方式在本公司一楼会议室召开，会议通知于2026年11月16日以电子邮件和书面方式发出。会议由公司董事长孙清焕先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中出席现场会议董事4名，以通讯表决方式参会董事2名；会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1．审议并通过《关于拟与江西省吉安市井冈山经济技术开发区招商管理有限公司签订投资合同书暨对外投资的议案》

经董事会审议，同意公司与江西省吉安市井冈山经济技术开发区招商管理有限公司签订《半导体封装研发制造项目投资合同书》，拟在井冈山经济技术开发区投资建设半导体芯片封测项目及半导体封装项目，预计2028年底总投资额22.5亿元，购置固晶、焊线、塑封、测试等核心设备开展研发制造，产品包括但不限于照明电源管理芯片封测、照明控制驱动芯片封测及Mini/Micro LED封测产品，本项目投资资金来源为公司自有资金加自筹资金，同时提请董事会授权经理层根据项目的实际情况办理本次投资具体事宜（包括但不限于签署本项目相关协议、技术手段选择、办理项目开工、施工及竣工手续等）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于拟与江西省吉安市井冈山经济技术开发区招商管理有限公司签订投

资合同书暨对外投资的公告》具体内容详见公司2026年11月21日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1．木林森股份有限公司第六届董事会第十次会议决议；

2．《半导体封装研发制造项目投资合同书》。

特此公告。

木林森股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日